

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-067

深圳市则成电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年11月20日

活动地点：线上交流会

参会单位及人员：申万宏源

上市公司接待人员：公司财务总监、董事会秘书：魏斌先生；公司证券事务代表：刘旭南先生

三、投资者关系活动主要内容

本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下：

问题 1：公司 2024 年前三季度业绩情况不错，能否简单介绍一下？

回复：公司 2024 年前三季度实现营业收入 2.78 亿元，同比增长 21.50%，实现净利润 2,070.16 万元，同比增长 9.98%。公司 2024 年前三季度营业收入和净利润的增长，主要得益于印制电路板和食品医疗类产品收入的增长。印制电路板收入增长主要系公司全资子公司广东则成科技有限公司产能提升，交付能力及产品可靠性持续增强，公司订单量增长。食品医疗类产品收入增长得益于老客户产品销售量稳定的同时，外销新产品医疗产品部件销售额有较快增长。

问题 2：2024 年第三季度报告显示，公司的研发投入同比增长较多，请问是何原因？有没有相应的成果？

回复：则成电子向来高度重视研发创新，在这方面持续投入资源，取得了一系列成果，为公司未来的发展打下了良好基础。公司 2024 年前三季度研发投入达 1,761.35 万元，同比增长 40.23%，主要系公司全资子公司广东则成科技有限公司、惠州市则成技术有限公司本年在重点研发项目加大研发投入影响所致。

在技术成果上，广东则成科技有限公司运用自研 Fine Pitch Subtractive (FIPIS) 细间距减除法，已具备线宽/线距为 15 μ m/15 μ m 的样品制造能力，这一成果使公司在高精度线路板制造领域处于行业先进水平，能够满足对线路板精细度要求极高的产品需求，如高端消费电子、部分精密医疗设备等领域的产品制造，为公司开拓高端市场奠定了技术基础。同时，公司持续开展用于高精密线路板制造的改良型 RCC 材料的研究，以及针对高端智能穿戴设备（如 AI-AR 眼镜、医疗级助听器）的 HDI 任意阶互联线路板产品研究等项目。

未来，这些研发投入和成果将持续推动公司发展。一方面，有助于公司不断优化产品结构，提高产品附加值，满足不同客户群体在性能、功能和成本等方面多样化的需求，进一步巩固和扩大客户群体；另一方面，使公司能够紧跟行业技术发展趋势，提前布局新兴技术领域，特别是对高性能印制电路板有广泛需求的领域，为实现公司长期可持续发展提供源源不断的动力。

问题 3：公司在光模块 PCB 领域的业务进展，是否存在突破？

回复：公司基于自研 RCC 类材料 NBCF 以及 FIPIS 技术（细间距减除法）建立 HDI PCB 产品线，目标成为则成电子的第二增长曲线。为满足市场对 800G 及以上的高速光模块 PCB 的需求，公司从去年四季度开始，持续向全球头部光模块厂商推广对应的 PCB 产品，目前已完成送样的绝大部分为 1.6T 光模块规格的研

发类产品。与此同时，光模块厂商将量产订单分配给合格供应商之前，通常都需要经过完整的招投标流程，因此积极参与主流光模块厂商 2025 年上半年招标是公司第四季度的重点工作，目标是通过中标来获得明年上半年量产产品订单。鉴于全球光模块制造厂商的出货主要以 400G 规格为主，公司将明年上半年目标锁定为 400G 光模块用 PCB 的大批量交付，同时与光模块厂商积极推动 800G/1.6T 光模块产品实现批量生产的进程。该目标能否实现取决于市场状况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险，相关进展公司将及时履行信息披露义务。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日